

メイコー多層放熱基板

R&D

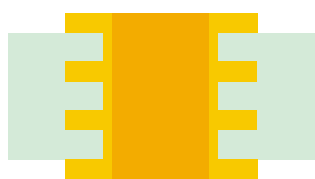
Meiko-Heat dissipation Multi PWB

各種基板構造を組み合わせたメイコー独自の多層放熱基板をご提案いたします。

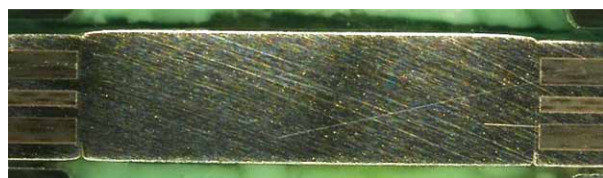
組み合わせ構成例

大電流 + 放熱

厚銅基板 + 銅インレイ構造

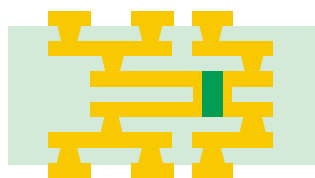


外層銅厚: $210\mu\text{m}$
内層銅厚: $175\mu\text{m}$
銅インレイ径: $\phi 6$



大電流ユニット直下の部品放熱性に効果大

厚銅基板 (ビルドアップ構造)

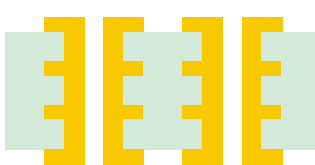


全層銅厚: $105\mu\text{m}$
ビルドアップ構造

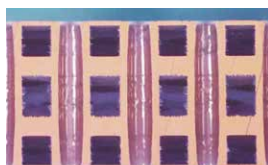


放熱経路 (基板設計) 自由度UP

厚銅基板 (スーパーメガスルホール構造)



内層: $210\mu\text{m}$
THめっき厚: $85\mu\text{m}$



TH内に大電流印可○
(THめっき厚コントロール可)

3D実装 + 放熱

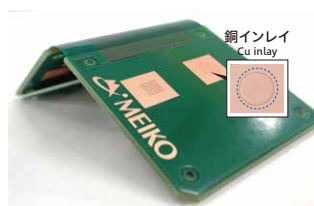
FR4-Flex基板 + 銅インレイ基板 フレックスリジッド基板 + 銅インレイ基板



FR4-Flex



フレックスリジッド構造



銅インレイ
Cu inlay

3次元構造基板に
高放熱特性をプラス

パワー素子内蔵 + 放熱

部品内蔵 (厚銅めっき接続) 構造



内蔵部品

内蔵部品

銅ブロック

L2,3銅厚: $200\mu\text{m}$

L3上に銅ブロック (1mmt) はんだ実装



銅ブロック実装により、内蔵部品の放熱特性UP

その他、様々な組み合わせ構造の基板も対応いたします。